

天虹科技股份有限公司

職缺	獎助學金/待遇	實習地點	實習時間	其他
製造組裝工程師3名	依工作類別面談後 通知薪資待遇	新竹縣湖口鄉仁 愛路1號	實習期間：112/7~112/12 (可另議) 上班時間：09:00~18:00 中午休息：12:00~13:00 每日上班 8 小時 周休 2 日	是否需面試：是 是否有勞健保(依工作類別另有團保)：有 是否提供午餐(有伙食津貼): 午餐自理 是否輪班：否 是否提供住宿：否 是否提供交通車:否

一、需求對象：大三、大四學生優先，其他年級亦可

二、需求條件及實習內容項目：

製造組裝工程師：半導體設備機台組立、裝配、修改

- 1.細心、積極，邏輯思考能力佳
- 2.具強烈上進心願接受培訓者
- 3.懂電子電路設計、熟 Solidworks 者尤佳

三、其他：

實習期間表現優異者優先轉正錄用